

## 略語（本号で使った主な略語）

BPD	Basal Plane Dislocation	基底面転位
CMOS	Complementary Metal-Oxide-Semiconductor	
DCB	Direct Copper Bonding	
DFN	Dual Flat Nonlead	
DPF	Diesel Particulate Filter	ディーゼル微粒子捕集フィルタ
ECU	Engine Control Unit	エンジンコントロールユニット
EGR	Exhaust Gas Recirculation	排気再循環
EMC	Electromagnetic Compatibility	電磁両立性
EV	Electric Vehicle	電気自動車
FTPS	Fuel Tank Pressure Sensor	燃料タンク圧センサ
FWD	Free Wheeling Diode	
HBM	Human Body Model	
HEV	Hybrid Electric Vehicle	ハイブリッド自動車
HPM	High Power Module	
IGBT	Insulated Gate Bipolar Transistor	
IoT	Internet of Things	
IPM	Intelligent Power Module	
IPS	Intelligent Power Switch	
JFET	Junction Field-Effect Transistor	
LRT	Load Ratio Control Transformer	負荷時タップ切替変圧器
MAP	Manifold Absolute Pressure	
MCR	Multivariate Curve Resolution	多変量スペクトル分解法
MEMS	Micro Electro Mechanical Systems	微小電気機械システム
MOSFET	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor	
PCS	Power Conditioning System	パワーコンディショナ
PFC	Power Factor Correction	力率改善
PiN	P-intrinsic-N	
PL	Photoluminescence	フォトルミネッセンス
PV	Photovoltaic	太陽光発電
PWM	Pulse Width Modulation	パルス幅変調
RB-IGBT	Reverse-Blocking IGBT	逆阻止 IGBT
RC-IGBT	Reverse-Conducting IGBT	逆導通 IGBT
SBD	Schottky Barrier Diode	
SIMS	Secondary Ion Mass Spectrometry	二次イオン質量分析法
SVC	Static Var Compensator	無効電力補償装置
SVR	Step Voltage Regulator	ステップ電圧調整器
TED	Threading Edge Dislocation	貫通刃状転位
TMAP	Temperature Manifold Absolute Pressure	
TRPL	Time Resolved PL	時間分解フォトルミネッセンス
UPS	Uninterruptible Power System	無停電電源装置

## 商標（本号に記載した主な商標または登録商標）

PrimePACK™

Infineon Technologies AG の商標または登録商標

その他の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標または登録商標である。

---

訂正：富士電機技報. 2017, vol.90, no.3, p.136, 右側 7 行目

(正)

また，これまでに電気接点の接触圧力と接触抵抗の関係のデータを蓄積している。

(誤)

また，これまでに電気接点の接点圧力と接触抵抗の関係のデータを蓄積している。



\*本誌に記載されている会社名および製品名は、それぞれの会社が所有する  
商標または登録商標である場合があります。